

2022-2028年中国集成电路 设备及关键原材料行业分析与投资战略研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国集成电路设备及关键原材料行业分析与投资战略研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202208/312819.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2022-2028年中国集成电路设备及关键原材料行业分析与投资战略研究报告》共八章。首先介绍了集成电路设备及关键原材料行业市场发展环境、集成电路设备及关键原材料整体运行态势等，接着分析了集成电路设备及关键原材料行业市场运行的现状，然后介绍了集成电路设备及关键原材料市场竞争格局。随后，报告对集成电路设备及关键原材料做了重点企业经营状况分析，最后分析了集成电路设备及关键原材料行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路设备及关键原材料产业有个系统的了解或者想投资集成电路设备及关键原材料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：集成电路设备及关键原材料概念界定及发展环境剖析

1.1 集成电路设备及关键原材料的概念界定及统计口径说明

1.1.1 集成电路设备及关键原材料界定

1.1.2 集成电路设备及关键原材料的分类

（1）集成电路设备

（2）集成电路材料

1.1.3 本报告数据来源及统计口径说明

1.2 集成电路设备及关键原材料行业政策环境分析

1.2.1 行业监管体系及机构

1.2.2 行业规范标准

1.2.3 行业发展相关政策规划汇总及解读

（1）国家政策

（2）地方政策

1.2.4 政策环境对集成电路设备及关键原材料行业发展的影响分析

1.3 集成电路设备及关键原材料行业经济环境分析

1.3.1 国际宏观经济发展

（1）美国

(2) 欧盟

(3) 日本

1.3.2 中国宏观经济发展

(1) GDP发展现状

(2) 工业增加值

(3) 固定资产投资

1.3.3 宏观经济发展展望

(1) 国际宏观经济预测

(2) 中国宏观经济预测

1.3.4 经济环境对集成电路设备及关键原材料行业发展的影响分析

1.4 集成电路设备及关键原材料行业社会环境分析

1.4.1 居民收入与支出水平

(1) 居民收入水平及结构

(2) 居民支出水平及消费结构

1.4.2 中国电子信息产业发展

(1) 电子信息制造业发展现状分析

(2) 电子信息行业前景与趋势分析

1.4.3 经济转型升级发展

1.4.4 社会环境对集成电路设备及关键原材料行业发展的影响分析

1.5 集成电路设备及关键原材料行业技术环境分析

1.5.1 集成电路行业技术迭代历程

1.5.2 存储芯片制程演进

(1) 存储芯片结构演变

(2) 对集成电路设备及原材料的影响

1.5.3 尺寸缩减及3D结构化发展

1.5.4 研发经费投入情况

1.5.5 技术环境对集成电路设备及关键原材料行业发展的影响分析

1.6 集成电路设备及关键原材料行业发展机遇与挑战

第2章：集成电路行业发展及集成电路设备、关键原材料的地位分析

2.1 全球集成电路行业发展分析

2.1.1 全球集成电路行业整体规模

- (1) 全球半导体销售规模
- (2) 全球集成电路销售规模
- 2.1.2 全球集成电路行业应用结构分析
- 2.1.3 全球集成电路行业产品结构分析
- 2.1.4 全球集成电路行业区域发展分析
- 2.1.5 全球集成电路行业发展前景分析
- 2.2 中国集成电路行业发展分析
- 2.2.1 中国集成电路行业整体发展情况
 - (1) 市场规模
 - (2) 市场结构
- 2.2.2 中国集成电路设计业发展
 - (1) 集成电路设计业企业数量
 - (2) 中国集成电路设计业市场规模
 - (3) 中国集成电路设计业区域竞争
 - (4) 集成电路设计业市场结构
- 2.2.3 中国集成电路制造业发展
 - (1) 集成电路制造业生产情况
 - (2) 集成电路制造业市场规模
 - (3) 集成电路制造业区域竞争
- 2.2.4 中国集成电路封装测试业发展
 - (1) 集成电路封装测试业市场规模
 - (2) 集成电路测试封装业企业分布
- 2.2.5 中国集成电路行业发展趋势分析
 - (1) 集成电路行业区域发展趋势
 - (2) 集成电路行业技术发展趋势
 - (3) 集成电路行业产品结构趋势
 - (4) 集成电路行业市场竞争趋势
 - (5) 中国半导体行业发展前景预测
- 2.3 集成电路设备及关键原材料在集成电路行业中的位置
- 2.3.1 集成电路设备在产业链中的位置
- 2.3.2 集成电路原材料在产业链中的位置
- 2.4 集成电路设备对集成电路行业发展的影响分析

2.5 集成电路关键原材料对集成电路行业发展的影响分析

第3章：全球集成电路设备及关键原材料发展现状及趋势前景分析

3.1 全球集成电路设备及关键原材料发展现状分析

3.1.1 全球集成电路设备及关键原材料发展历程

(1) 全球集成电路设备发展历程

(2) 全球集成电路材料发展历程

3.1.2 全球集成电路设备及关键原材料发展现状

(1) 全球集成电路设备发展现状

(2) 全球集成电路材料发展现状

3.1.3 全球集成电路设备及关键原材料竞争格局分析

(1) 区域竞争

(2) 品牌竞争

3.2 全球主要区域集成电路设备及关键原材料发展现状分析

3.2.1 全球集成电路产业转移状况

3.2.2 韩国集成电路设备及关键原材料发展分析

(1) 韩国半导体行业发展情况

(2) 韩国集成电路设备行业发展情况

(3) 韩国集成电路材料行业发展情况

3.2.3 北美集成电路设备及关键原材料发展分析

(1) 北美集成电路行业发展情况

(2) 北美集成电路设备行业发展情况

(3) 北美集成电路材料行业发展情况

3.2.4 日本集成电路设备及关键原材料发展分析

(1) 日本集成电路行业发展情况

(2) 日本集成电路设备行业发展情况

(3) 日本集成电路材料行业发展情况

3.3 全球集成电路设备及关键原材料主要企业发展分析

3.3.1 应用材料 (Applied Materials, Inc.)

(1) 企业基本情况介绍

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业半导体设备业务发展情况

(4) 企业在华业务布局

3.3.2 泛林半导体 (Lam Research)

(1) 企业基本情况介绍

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业半导体设备业务发展情况

(4) 企业在华业务布局

3.3.3 荷兰ASML (Advanced Semiconductor Material Lithography)

(1) 企业基本情况介绍

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业半导体设备业务发展情况

(4) 企业在华业务布局

3.3.4 日本揖斐电株式会社 (IBIDEN)

(1) 企业基本情况

(2) 企业经营情况

(3) 企业半导体材料业务布局

(4) 企业在华投资布局情况

3.3.5 日本信越化学工业株式会社

(1) 企业基本情况

(2) 企业经营情况

(3) 企业半导体材料业务布局

(4) 企业在华投资布局情况

3.3.6 日本株式会社SUMCO

(1) 企业基本情况

(2) 企业经营情况

(3) 企业半导体材料业务布局

(4) 企业在华投资布局情况

3.4 全球集成电路设备及关键原材料发展趋势及经验借鉴

3.4.1 全球集成电路设备及关键原材料发展趋势分析

(1) 半导体设备销售额

(2) 半导体材料销售额

3.4.2 全球集成电路设备及关键原材料发展的经验借鉴

(1) 全球半导体设备发展经验借鉴

(2) 全球半导体材料发展经验借鉴

第4章：中国集成电路设备及关键原材料发展现状分析

4.1 中国集成电路设备及关键原材料发展概述

4.1.1 集成电路设备及关键原材料发展历程分析

4.1.2 集成电路设备及关键原材料市场特征分析

4.2 中国集成电路设备及关键原材料市场供需状况分析

4.2.1 中国集成电路设备及关键原材料参与者类型及规模

4.2.2 中国集成电路设备及关键原材料供给水平

(1) 集成电路设备

(2) 集成电路原材料

4.2.3 中国集成电路设备及关键原材料需求状况

4.3 中国集成电路设备及关键原材料市场规模分析

4.3.1 中国集成电路设备及关键原材料行业市场规模分析

4.3.2 中国集成电路设备及关键原材料市场规模占全球比重

4.4 中国集成电路设备及关键原材料进出口市场分析

4.4.1 中国集成电路设备及关键原材料进口市场分析

(1) 集成电路设备进口情况

(2) 集成电路材料进口分析

4.4.2 中国集成电路设备及关键原材料出口市场分析

(1) 集成电路设备出口情况

(2) 集成电路材料出口情况

4.5 集成电路设备及关键原材料国产化进程分析

4.5.1 集成电路设备及关键原材料国产化进程

4.5.2 技术突破加速推进国产化进程

(1) 集成电路设备技术进程

(2) 集成电路材料技术进程

4.6 中国集成电路设备及关键原材料发展痛点分析

第5章：集成电路设备及关键原材料竞争状态及竞争格局分析

5.1 集成电路设备及关键原材料投资、兼并与重组分析

5.1.1 行业融资现状

(1) 国家集成电路产业大基金

(2) 投融资阶段及事件汇总

5.1.2 行业兼并与重组

(1) 兼并与重组现状

(2) 兼并与重组案例

5.2 集成电路设备及关键原材料波特五力模型分析

5.2.1 集成电路设备波特五力模型分析

(1) 现有竞争者之间的竞争

(2) 行业潜在进入者威胁

(3) 行业替代品威胁分析

(4) 行业供应商议价能力分析

(5) 行业购买者议价能力分析

(6) 行业竞争情况总结

5.2.2 集成电路材料行业波特五力模型分析

(1) 现有竞争者之间的竞争

(2) 关键要素的供应商议价能力分析

(3) 消费者议价能力分析

(4) 行业潜在进入者分析

(5) 替代品风险分析

(6) 竞争情况总结

5.3 中国集成电路设备及关键原材料企业竞争格局分析

5.3.1 中国集成电路设备企业竞争格局

5.3.2 中国集成电路材料企业竞争格局

5.4 中国集成电路设备及关键原材料全球竞争力分析

5.4.1 中国集成电路设备全球竞争力分析

5.4.2 中国集成电路材料全球竞争力分析

第6章：中国集成电路设备及关键原材料细分市场分析

6.1 中国集成电路设备及关键原材料构成分析

6.1.1 中国集成电路设备构成

6.1.2 中国集成电路关键原材料构成

6.2 中国集成电路设备细分市场分析

6.2.1 中国半导体光刻设备行业发展分析

- (1) 半导体光刻工艺概述
- (2) 半导体光刻技术发展分析
- (3) 半导体光刻机发展现状分析
- (4) 光刻机竞争格局
- (5) 光刻机国产化现状
- (6) 半导体光刻设备发展趋势分析

6.2.2 中国半导体刻蚀设备行业发展分析

- (1) 半导体刻蚀工艺概述
- (2) 半导体刻蚀工艺发展情况
- (3) 半导体刻蚀设备发展现状分析
- (4) 半导体刻蚀设备发展趋势分析

6.2.3 中国半导体清洗设备行业发展分析

- (1) 半导体清洗工艺概述
- (2) 半导体清洗技术发展分析
- (3) 半导体清洗技术——干法清洗
- (4) 半导体清洗设备发展现状分析
- (5) 半导体清洗设备竞争格局
- (6) 半导体清洗设备国产化现状
- (7) 半导体清洗设备发展趋势分析

6.2.4 中国半导体薄膜沉积设备行业发展分析

- (1) 半导体薄膜沉积工艺概述
- (2) 半导体薄膜沉积技术发展分析
- (3) 半导体薄膜沉积设备发展现状分析
- (4) 半导体薄膜沉积设备发展趋势分析

6.2.5 中国半导体封装设备行业发展分析

- (1) 半导体封装工艺概述
- (2) 半导体封装技术发展分析
- (3) 半导体封装设备发展现状分析
- (4) 半导体封装设备发展趋势分析

6.2.6 中国半导体测试设备行业发展分析

- (1) 半导体测试工艺概述

- (2) 半导体测试技术发展分析
- (3) 半导体测试设备发展现状分析
- (4) 半导体测试设备发展趋势分析

6.2.7 中国半导体制造其他设备发展分析

- (1) 单晶炉设备
- (2) 氧化/扩散设备
- (3) 离子注入设备

6.3 中国集成电路关键原材料细分市场分析

6.3.1 中国半导体材料（前端晶圆制造材料）发展现状及趋势分析

- (1) 中国半导体硅片发展现状及趋势分析
- (2) 中国电子特气发展现状及趋势分析
- (3) 中国光掩膜版发展现状及趋势分析
- (4) 中国光刻胶及配套材料发展现状及趋势分析
- (5) 中国抛光材料发展现状及趋势分析
- (6) 中国湿电子化学品发展现状及趋势分析
- (7) 中国靶材发展现状及趋势分析

6.3.2 中国半导体材料（后端封装材料）发展现状及趋势分析

- (1) 中国封装基板发展现状及趋势分析
- (2) 中国引线框架发展现状及趋势分析
- (3) 中国键合线发展现状及趋势分析
- (4) 中国塑封料发展现状及趋势分析
- (5) 中国陶瓷封装材料发展现状及趋势分析

第7章：中国集成电路设备及关键原材料行业领先企业生产经营分析

7.1 集成电路设备及关键原材料代表企业概况

7.2 集成电路设备代表性企业案例分析

7.2.1 中微半导体设备（上海）股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业集成电路设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态

(6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.2 北方华创科技集团股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况分析

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业半导体设备业务布局

(5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态

(6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.3 沈阳芯源微电子设备股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况分析

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业半导体设备业务布局

(5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态

(6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.4 杭州长川科技股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况分析

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业半导体设备业务布局

(5) 企业半导体设备战略布局

(6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.5 苏州赛腾精密电子股份有限公司

(1) 企业基本信息简介

(2) 企业经营状况分析

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业半导体设备业务布局

(5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态

(6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.6 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

(1) 企业基本信息简介

(2) 企业经营状况分析

- (3) 企业业务结构及主要客群
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.7 武汉精测电子集团股份有限公司

- (1) 企业基本信息简介
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.8 北京屹唐半导体科技有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.9 上海微电子装备（集团）股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业融资历程
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.10 沈阳拓荆科技有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业销售网络分析
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业融资历程
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.3 集成电路关键原材料代表性企业案例分析

7.3.1 浙江金瑞泓科技股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业集成电路材料业务布局
- (5) 企业集成电路材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展集成电路材料业务的优劣势分析

7.3.2 宁波江丰电子材料股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业靶材产品结构
- (5) 企业集成电路材料战略布局
- (6) 企业发展集成电路材料业务的优劣势分析

7.3.3 有研新材料股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业集成电路材料业务布局
- (5) 企业集成电路材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展集成电路材料业务的优劣势分析

7.3.4 上海硅产业集团股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业集成电路材料业务布局
- (5) 企业集成电路材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

7.3.5 天津中环半导体股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析

- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业集成电路材料业务布局
- (5) 企业集成电路材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展集成电路材料业务的优劣势分析

7.3.6 湖北鼎龙控股股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业集成电路材料业务布局
- (5) 企业集成电路材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展集成电路材料业务的优劣势分析

7.3.7 苏州金宏气体股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 公司气体供应模式分析
- (5) 企业销售渠道和网络分析
- (6) 企业经营状况优劣势分析

7.3.8 江阴江化微电子材料股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业电子化学品业务分析
- (5) 企业市场渠道与网络
- (6) 企业发展优劣势分析

7.3.9 苏州晶瑞化学股份有限公司

- (1) 企业基本信息
- (2) 企业经营状况介绍
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业光刻胶业务布局
- (5) 企业发展光刻胶业务的优劣势分析

7.3.10 台湾欣兴电子股份有限公司

- (1) 企业基本情况
- (2) 企业经营情况
- (3) 企业集成电路材料业务布局
- (4) 企业在华投资布局情况

第8章：中国集成电路设备及关键原材料发展前景预测与投资机会分析（）

8.1 集成电路设备及关键原材料投资潜力分析

8.1.1 行业生命周期分析

8.1.2 行业发展潜力分析

8.2 集成电路设备及关键原材料发展前景预测

8.2.1 集成电路设备及关键原材料行业发展趋势

(1) 集成电路设备

(2) 集成电路材料

8.2.2 集成电路设备及关键原材料行业发展前景预测

8.3 集成电路设备及关键原材料投资特性分析

8.3.1 行业进入壁垒分析

8.3.2 行业投资风险预警

8.4 集成电路设备及关键原材料投资价值与投资机会

8.4.1 行业投资价值分析

8.4.2 行业投资机会分析

8.5 集成电路设备及关键原材料投资策略与可持续发展建议

8.5.1 行业投资策略分析

8.5.2 行业可持续发展建议（）

部分图表目录：

图表1：芯片制造产业链

图表2：半导体设备的分类

图表3：集成电路材料分类

图表4：本报告的主要数据来源说明

图表5：中国集成电路设备及关键原材料行业监管体系及机构介绍

图表6：截至2021年末中国集成电路设备及关键原材料行业相关标准汇总

图表7：2016-2020年中国半导体设备及关键原材料行业发展政策汇总及解读

图表8：截至2021年各区域半导体设备及关键原材料行业相关政策汇总

图表9：2016-2020年美国GDP走势（单位：万亿美元，%）

图表10：2016-2020年欧盟27国GDP走势（单位：万亿欧元，%）

图表11：2016-2020年日本GDP走势（单位：万亿日元，%）

图表12：2016-2020年中国国内生产总值（GDP）走势（单位：万亿元，%）

图表13：2016-2020年中国工业增加值走势（单位：万亿元，%）

图表14：2016-2020年全国固定资产投资及增长速度（单位：万亿元，%）

图表15：2022-2028年全球部分国家/地区经济预测（单位：%）

图表16：2021年中国GDP增长率预测（单位：%）

图表17：2016-2020年居民人均可支配收入走势图（单位：元，%）

图表18：2016-2020年中国居民人均消费支出（单位：元）

图表19：2020年中国居民人均消费支出结构（单位：%）

图表20：2016-2020年电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速（单位：%）

图表21：半导体行业技术迭代历程

图表22：存储芯片结构演变

图表23：2Xnm DRAM对比28nm逻辑电路制程前道加工步骤增量

图表24：2016-2020年中国研究与试验发展（R&D）经费支出情况（单位：亿元，%）

图表25：中国集成电路设备及关键原材料行业发展机遇与挑战分析

图表26：2016-2020年全球半导体产业销售额情况（单位：亿美元，%）

图表27：2016-2020年全球集成电路产品市场规模（单位：亿美元）

图表28：2016-2020年全球集成电路应用结构（单位：%）

图表29：2016-2020年全球集成电路产品市场规模（单位：%）

图表30：2020年全球半导体产业销售额区域分布（单位：亿美元，%）

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202208/312819.html>